

项目	加工能力	工艺详解
层数	1~14层	
板材类型	FR-4,铝基板	
最大尺寸	120cm×120cm	尺寸超过38cm×38cm的需要审核资料确认
外形尺寸精度	±0.1mm	锣板外形公差±0.2mm
板厚范围	双面板：0.2-7.0mm 多层板：0.4-8.0mm	
板厚公差 (T≥1.0mm)	± 10%	比如板厚T=1.6mm，实物板厚为1.44mm (T - 1.6×10%) ~1.76mm (T + 1.6×10%)
板厚公差 (T < 1.0mm)	±0.1mm	比如板厚T=0.8mm，实物板厚为0.7mm (T-0.1) ~0.9mm (T+0.1)
最小线宽 &间距	3.0 mil (0.075mm)	
成品外层 铜厚	1OZ~6OZ (35um~105um)	默认常规电路板外层铜箔线路厚度为1OZ，可做6OZ (需下单备注说明)
成品内层 铜厚	1OZ~6OZ (35um~105um)	默认常规电路板外层铜箔线路厚度为1OZ，可做6OZ (需下单备注说明)
钻孔孔径	0.2mm机械钻孔 0.075mm(3mil)激光钻孔	最小孔径0.2mm，最大孔径6.3mm，如果大于6.3mm工厂要另行处理。机械钻头规格为0.05mm为一阶，如0.3mm，0.35mm，0.4mm...
过孔单边 焊环	3mil	如导电孔或插件孔单边焊环过小，但该处有足够大的空间时则不限制焊环单边的大小；如该处没有足够大的空间且有密集走线，则最小单边焊环不得小于6mil
纵横比	13 : 1	板厚孔径比
阻焊类型	感光油墨	
最小字符宽	0.15mm(6mil)	字符最小的宽度，如果小于6mil，实物板可能会因设计原因而造成字符不清晰
走线和焊盘 距板边距离	≥0.3mm	锣板出货，线路层走线距板子外形线的距离不小于0.3mm； V割拼板出货，走线距V割中心线距离不能小于0.4mm
走线与外形间距	≥6mil	如导电孔或插件孔单边焊环过小，但该处有足够大的空间时则不限制焊环单边的大小；如该处没有足够大的空间且有密集走线，则最小单边焊环不得小于6mil
半孔工艺 最小孔径	0.6mm	半孔工艺是一种特殊工艺，最小孔径不得小于0.6mm